

6-103329-0 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

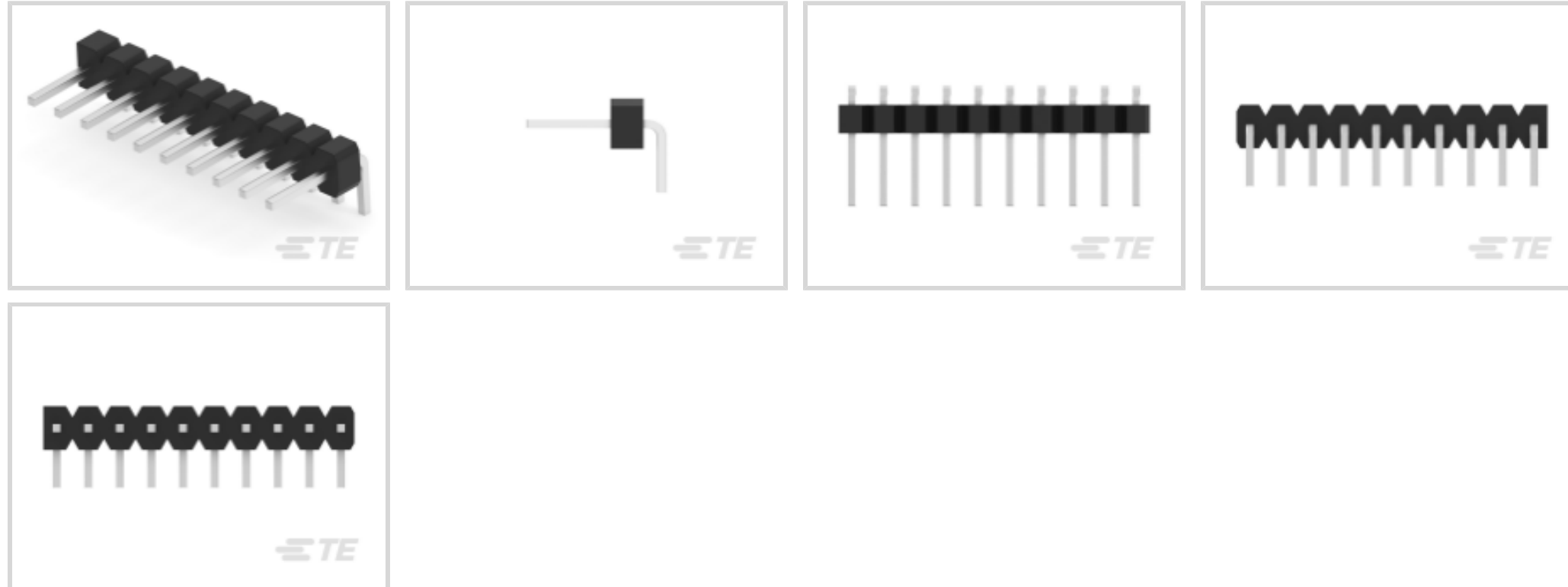
TE 内部编号 6-103329-0

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, Tin, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 分离       |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数        | 10 |
| 行数        | 1  |
| PCB 安装方向  | 直角 |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 接合方柱尺寸 | .64 mm [.025 in] |
|--------|------------------|

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
|                | 100 – 200 µin                 |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin] |
| 端子形状和构造        | 正方形                           |
| 端子底板材料         | 镍                             |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡                             |
| 端子基材           | 磷青铜                           |
| 端子接触部电镀材料      | 锡                             |
| 端子类型           | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A                           |

### 端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.05 mm[.12 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

### 机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 热塑性            |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

### 尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |
|------------|-----------------|

### 使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准                         |
| 工作温度范围  | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 50     |
| 封装方法 | Carton |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。  |
| 焊接工艺能力  | 尚未进行焊接工艺可能性审核   |

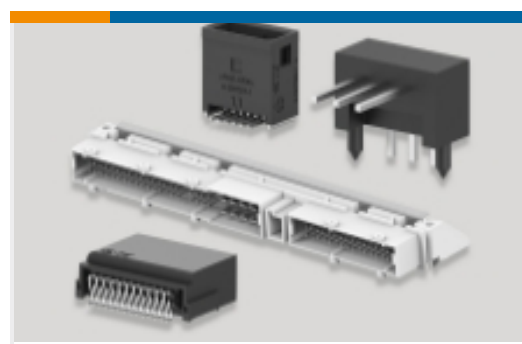
### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

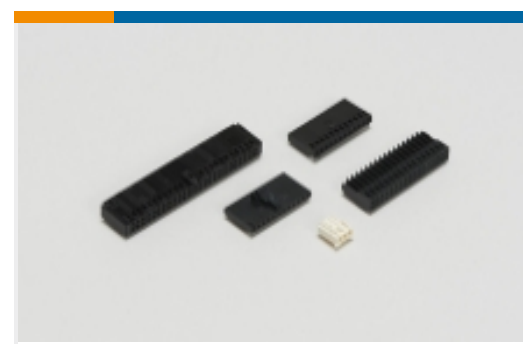
## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [AMPMODU Headers](#)



PCB 板端连接器及母端(4379)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(2)



连接器端子(64)

## 客户还购买了

TE 产品编号1565917-4  
EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM  
SOCKET 200P 5.2HTE 产品编号5558310-1  
MOD/JK,ASSY,8 POS,R/A,KEY/SHLDTE 产品编号5-532956-2  
16 MODII 2PC CE RCPT ASSY, RoH

## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-103329-0\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-103329-0\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-103329-0\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU Interconnection System](#)



## AMPMODU Interconnection System

英文版本